

高导热环氧树脂填料系列(ZH-D)

产品名称	高导热环氧树脂填料系列(ZH-D)
公司名称	合肥中航纳米技术发展有限公司
价格	.00/千克
规格参数	中航纳米:中航 高导热灌封胶填料:ZH-D 安徽:合肥
公司地址	: 安徽-合肥-长丰县岗集工业园万安大道4号
联系电话	0551-65110318 15256249472

产品详情

导热现状

随着信息时代快速发展，工业技术的发展与人们生活水平的提高，对工业电子电力产品与消费产品的更高性能化、小型化提出了更高的要求，市场对导热填料的要求越来越高，而常规的Al₂O₃、MgO、ZnO、NiO等无机导热介质材料已难以满足5G通信PCB覆铜板、大功率LED灯、硅胶、硅胶片、pi膜、超高压电路等高导热、高绝缘、耐高电压的需求。之前靠高填充量的球形氧化铝做导热主体的导热粉，已经不能满足目前导热产品的需要了。合肥中航纳米公司，经过多年的研究与创新，成功开发出了一系列不同高分子体系的高导热填料，通过特殊设备工艺，对高导热填料进行晶体生长，让导热填料形成致密的晶态，从而形成致密的导热网状结构，减少晶格缺陷，搭建一条声子传热导热通道。合肥中航纳米利用自身的纳米技术优势，对导热填料进行表面纳米有机化包裹处理，使导热填料与高分子有很好的相容性及大填充量，导热填料表面有3~5纳米的有机包裹层，既能起到改性与分散的作用，又不会阻碍导热网络的形成。

产品简介

高导热环氧树脂填料（ZH-D）以高导热无机复合陶瓷材料为主体填料，采用特殊处理剂纳米化包覆而成，在环氧树脂中拥有良好的分散性和高填充性。由其制备的环氧树脂胶的导热系数高，手感细腻，柔性好，流动性好。高导热环氧树脂填料（ZH-D）纯度高、粒度经过合理的复配（5:3:2），表面有机包裹膜很薄，达到3-5纳米，易于分散，与有机体很好相容。高导热环氧树脂填料（ZH-D）经过特殊工艺高温结晶化处理，有很高的导热系数与传热性，目前普遍应用于高端环氧树脂胶中的绝缘导热。

产品参数

产品	高导热环氧树脂填料（ZH-D）
产品型号	ZH-D
平均粒度	3~5um（复配比例5:3:2）
产品纯度	99.9%

理论密度	2.762g/cm ³
电导率	<100 μ s/cm
吸油值	15ml/100g
导热率	170W/M.K(陶瓷粉压制陶瓷片)
含水量	0.5%
外观	灰白色粉末
主要成分	高导热无机复配陶瓷材料
导热环氧树脂 (hotdisk)	2.0-3.5W/m.K及以上

产品特点

- 1、高导热环氧树脂填料 (ZH-D) 经表面改性处理，包裹膜厚度纳米化，吸油值低，与环氧树脂相容性好，制品成型性和柔韧性良好；
- 2、纯度高、粒度经过合理的复配 (5:3:2)，在基材中可以大程度地添加，形成高效的导热网络通路，搭建一条完整的声子传热通道；
- 3、高导热环氧树脂填料 (ZH-D) 应用范围广，可以制备2-3.5W/m.K及以上的高导热环氧树脂胶；
- 4、高导热环氧树脂填料 (ZH-D) 属于无机导热陶瓷范畴，所以符合欧盟环保标准，是一种无机环保型高导热填料。技术支持

中航纳米可以提供高导热环氧树脂填料 (ZH-D) 在导热环氧树脂胶、导热树脂、导热泥、绝缘导热灌封胶等绝缘导热材料中的应用技术支持，具体应用咨询请与市场部人员联系。咨询sales@hfzhnano.com
QQ : 3355407318

包装储存：1、本品为尼龙袋充氮气包装，密封保存于干燥、阴凉的环境中，不宜暴露空气中，防受潮发生团聚，影响分散性能和使用效果；

2、即开即用，如若拆包未使用完，请重新封口；

3、在使用过程中，如不慎进入眼睛请及时用淡水冲洗，严重者就医治疗；

4、客户在条件容许的情况下，在混合搅拌的时候，进行抽真空处理（排除水分和空气的干扰），这样调配的胶料导热性能更优；

5、常规包装5Kg一袋充氮气包装，25Kg一纸板桶，包装数量可以根据客户要求分装。